

北京市海问律师事务所

关于盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor
Corporation）

首次公开发行股票并在科创板上市
之参与战略配售的投资者专项核查的

法律意见书

二〇二六年三月

海问律师事务所 HAIWEN&PARTNERS

北京市海问律师事务所

地址：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层（邮编100020）
Address: 20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话 (Tel): (+8610)85606888 传真 (Fax): (+8610)85606999 www.haiwen-law.com

北京 BEIJING | 上海 SHANGHAI | 深圳 SHENZHEN | 香港 HONGKONG | 成都 CHENGDU

北京市海问律师事务所

关于盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）

首次公开发行股票并在科创板上市

之参与战略配售的投资者专项核查的

法律意见书

致：中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司

盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）（以下简称“**发行人**”或“**公司**”）申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“**本次发行**”），本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“**本次战略配售**”）、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式。中国国际金融股份有限公司（以下简称“**中金公司**”或“**主承销商**”），担任本次发行的保荐人及主承销商；中信证券股份有限公司（以下简称“**中信证券**”，与中金公司合称“**联席主承销商**”）为本次发行的联席主承销商。北京市海问律师事务所（以下简称“**本所**”或“**我们**”）受联席主承销商的委托，就参与本次战略配售的投资者的配售资格是否符合法律法规的要求等相关事宜出具法律意见书（以下简称“**本法律意见书**”）。

为出具本法律意见书，本所核查了联席主承销商和参与本次战略配售的投资者按照本所要求而提供的必要文件，且已经得到联席主承销商和参与本次战略配售的投资者的如下保证：其为参与本次战略配售目的所提供的所有证照/证件及其他文件均真实、全面、有效、合法。

在审阅上述文件的基础上，本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《首次公开发行股票承销业务规则》《上海证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》（以下简称“**《发行承销实施细则》**”）等相关法律法规和上

海证券交易所业务规则（以下合称“**相关适用规则**”）的相关要求以及上海证券交易所的监管意见对本次战略配售相关事项进行了核查，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所特作如下声明：

1、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于监管机构、发行人、联席主承销商、参与本次战略配售的投资者或者其他有关机构出具的证明文件或口头陈述以及相关信息公开平台公示的信息出具相应的意见。

2、本所依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的有关法律、行政法规和规范性文件以及上海证券交易所的规定作出本法律意见书。本所认定某些事项是否合法有效是以该等事项发生之时所应适用的法律、行政法规和规范性文件以及上海证券交易所业务规则为依据，同时也充分考虑了监管机构给予的有关批准、确认和指示，无论是书面的或是口头的。

3、本所按照有关法律、行政法规、规范性文件及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，进行了必要的核查验证，并保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

4、本法律意见书仅供本次战略配售之目的使用。除此之外，未经本所书面许可，本法律意见书不得由任何其他人使用，或用作任何其他目的。

基于上述，本所作出如下法律意见：

一、参与战略配售的投资者的选择标准及配售资格

根据《发行承销实施细则》第四十一条，参与发行人战略配售的投资者主要包括：（一）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；（二）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；（三）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金；（四）参与科创板跟投的保荐人相关子公司；（五）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；（六）符合法律法规、业务规则规定的其他投资者。根据《证券发行与承销管理办法》第二十一条第三款，参与战略配售的投资者应当使用自有资金认购，不得接受他人委托或者委托他人参与配售，但依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金等除外。

根据联席主承销商提供的《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）首次公开发行股票并在科创板上市战略配售方案》（以下简称“《战略配售方案》”）等相关资料，并经本所律师核查，发行人和联席主承销商对参与本次战略配售的投资者的选择标准如下：

（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；

（2）参与科创板跟投的保荐人相关子公司；

（3）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。

根据联席主承销商提供的《战略配售方案》等相关资料，并经本所律师核查，共有 15 家投资者参与本次战略配售，该等投资者的名单和类型如下表所示：

序号	参与本次战略配售的投资者名称	参与战略配售的投资者类型
1	海光信息技术股份有限公司（以下简称“海光信息”）	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业
2	中微半导体（上海）有限公司（以下简称“中微半导体”）	
3	上海天数智芯半导体股份有限公司（以下简称“天数智芯”）	
4	北京摩笔生成科技有限公司（以下简称“摩笔生成”）	
5	沐曦数智（上海）科技有限公司（以下简称“沐曦数智”）	
6	北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”）	
7	聚辰半导体股份有限公司（以下简称“聚辰股份”）	
8	上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“复旦微电”）	
9	联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“联芸科技”）	
10	北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“昂瑞微”）	
11	唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“唯捷创芯”）	
12	上海华虹宏力半导体制造有限公司（以下简称“华虹宏力”）	
13	翱捷科技股份有限公司（以下简称“翱捷科技”）	
14	中金盛合芯途共赢一号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金盛合一号资管计划”）	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划
15	中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）	参与科创板跟投的保荐人相关子公司

（一）参与本次战略配售的投资者的基本情况

1、海光信息技术股份有限公司

（1）基本情况

根据海光信息的《营业执照》、公司章程等资料及海光信息的确认，并经本所律师于国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，海光信息的基本信息如下：

公司名称	海光信息技术股份有限公司
成立时间	2014年10月24日
统一社会信用代码	911201163004788158
法定代表人	沙超群
注册资本	232,433.8091 万元人民币
注册地址	天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-3-8
经营范围	集成电路、电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让；批发和零售业；计算机系统集成；物业管理；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经本所律师核查，海光信息系依法成立的股份有限公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形。

（2）股权结构和实际控制人

根据《海光信息技术股份有限公司2025年第三季度报告》等资料，海光信息为上海证券交易所科创板上市公司，股票代码为688041.SH。截至2025年9月30日，海光信息的前十大股东如下所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	曙光信息产业股份有限公司	649,900,000	27.96
2	天津海富天鼎科技合伙企业（有限合伙）	251,194,546	10.81
3	成都产业投资集团有限公司	167,600,000	7.21
4	成都蓝海轻舟企业管理合伙企业（有限合伙）	141,486,364	6.09
5	成都高新投资集团有限公司	137,600,000	5.92
6	成都高新集萃科技有限公司	90,000,000	3.87
7	李金阳	65,732,946	2.83
8	香港中央结算有限公司	52,750,336	2.27

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
9	中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	31,761,734	1.37
10	招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	31,042,003	1.34

根据《海光信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》《海光信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》及公开信息披露，截至 2025 年 9 月 30 日，海光信息无控股股东及实际控制人。

（3）关联关系

经本所律师核查，并经海光信息确认，海光信息与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

（4）战略配售资格

根据海光信息的确认，海光信息为上海证券交易所科创板上市公司，主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器，主要产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。海光 CPU 系列产品兼容 x86 指令集以及国际上主流操作系统和应用软件，软硬件生态丰富，性能优异，安全可靠，已经广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等重要行业或领域。海光 DCU 系列产品以 GPGPU 架构为基础，可广泛应用于大数据处理、人工智能、商业计算等应用领域。根据《海光信息技术股份有限公司 2025 年度业绩快报公告》，截至 2025 年 12 月 31 日，海光信息资产总额 356.87 亿元，2025 年度实现营业收入 143.76 亿元，归母净利润 25.42 亿元。因此，海光信息为大型企业。

根据发行人与海光信息签署的《战略合作备忘录》，双方拟就下述合作领域积极开展战略合作，包括但不限于：

1) 优势互补，打通高端芯片产业链关键瓶颈

双方优势高度互补，形成“芯片设计-先进封装-测试验证”协同闭环。海光信息需要先进封装技术来实现更高性能、更低功耗和更密集的集成度，从而支撑芯片性能升级，发行人需依托海光信息的设计经验与多样化产品验证工艺、拓展场景，共同定义和开发下一代先进封装方案。发行人在 2.5D 封装技术上国内领先，可以与海光协同推动新工艺的演进及良率的提升，也包括新一代封装技术与工艺

的开发与发展。在同等条件的情况下，海光信息将发行人作为核心优先合作供应商，优先向发行人采购先进封装服务。

2) 技术与研发层面：聚焦核心技术攻坚，深化协同创新

A) 面向高端计算的先进封装技术协同研发：Chiplet 技术适配海光信息 CPU/DCU 高端处理器的性能升级需求，同时契合发行人的先进封装技术发展方向。双方在此先进封装技术层面开展技术协同，共同致力于核心工艺与技术方案的研发创新。

B) 基于 Chiplet 设计标准与接口的协同开发：双方作为国内高端芯片设计与先进封装领域的核心企业，通过发挥各自技术优势，共同推进国产 Chiplet 互联标准的建立与完善，适配国产高端芯片异构集成需求；通过制定自主生态标准，降低不同国产芯片厂商之间集成的技术门槛，构建开放、共赢的产业生态。

C) 芯片测试技术协同研发与方案优化：双方后续开展芯片测试业务的协同研发与落地，将先进封装项目的测试环节纳入合作规划，稳步推进面向超高功耗异构芯片的集成测试解决方案，形成“先进封装+全流程高端测试”一体化流程。

海光信息的主要产品高端处理器需要芯粒多芯片集成封装（Chiplet）等先进封装技术来实现支撑性能升级，而发行人在 Chiplet 等先进封装技术上国内领先，因此，双方存在坚实的合作基础，以及未来扩大合作和优先合作的业务基础，上述《战略合作备忘录》的具体内容切实可行，所约定的战略合作条款具备在限售期内落地执行的有效基础。

因此，海光信息属于与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业，符合《发行承销实施细则》第四十一条第（一）项的规定，具有参与本次战略配售的资格。

根据海光信息出具的承诺函：1) 其具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序，参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域，不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其章程禁止或限制参与本次战略配售的情形；2) 其为本次战略配售股票的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；3) 其具备良好的市场声誉

和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量/金额的发行人股票。

(5) 参与战略配售的认购资金来源

根据海光信息出具的承诺函，其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金，且符合该资金的投资方向。经核查海光信息截至 2025 年 9 月 30 日的财务报表，海光信息的流动资产足以覆盖其与发行人签署的配售协议中约定的承诺认购金额。

2、中微半导体（上海）有限公司

(1) 基本情况

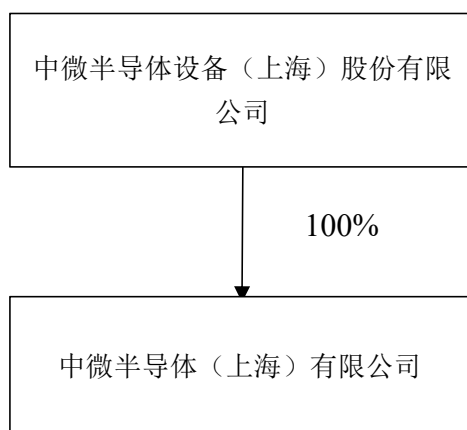
根据中微半导体的《营业执照》、公司章程等资料及中微半导体的确认，并经本所律师于国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，中微半导体的基本信息如下：

公司名称	中微半导体（上海）有限公司
成立时间	2020 年 6 月 12 日
统一社会信用代码	91310000MA1H33JQ23
法定代表人	尹志尧
注册资本	400,000 万元人民币
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区江山路 4168 号
经营范围	许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物联网科技、数据科技、电子信息科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备销售；电子专用设备制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；光电子器件销售；其他电子器件制造；电子产品销售；电子真空器件销售；新兴能源技术研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；智能控制系统集成；软件开发（音像制品、电子出版物除外）；物联网设备销售；数据处理服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；企业管理；知识产权服务（除专利）；非居住房地产租赁；物业管理；会议及展览服务；社会经济咨询服务（除金融）；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经本所律师核查，中微半导体系依法成立的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形。

(2) 股权结构和实际控制人

根据中微半导体的公司章程等资料及中微半导体的确认，并经本所律师于国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，截至本法律意见书出具之日，中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”）持有中微半导体100%股权，为中微半导体的控股股东与实际控制人。中微半导体的股权结构如下所示：



根据《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年第三季度报告》等资料，中微公司为上海证券交易所科创板上市公司，股票代码为 688012.SH。截至 2025 年 9 月 30 日，中微公司的前十大股东如下所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	上海创业投资有限公司	93,483,533	14.93
2	巽鑫（上海）投资有限公司	77,188,722	12.33
3	香港中央结算有限公司	55,893,895	8.93
4	华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	23,254,349	3.71
5	中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	14,945,374	2.39
6	招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	14,633,581	2.34
7	中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	9,937,033	1.59

8	中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	8,366,318	1.34
9	中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	7,503,520	1.20
10	中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	5,672,316	0.91

根据《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年半年度报告》《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》及公开信息披露，截至 2025 年 9 月 30 日，中微公司无控股股东及实际控制人。

（3）关联关系

经本所律师核查，并经中微半导体确认，中微半导体与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

（4）战略配售资格

根据中微半导体的确认，中微半导体是中微公司持股 100%的全资子公司。中微公司从事高端半导体设备及泛半导体设备的研发，于半导体领域，其致力于开发半导体制造环节所需的高端关键设备，包括等离子体刻蚀设备、薄膜沉积设备等，多款产品性能达到国际先进水平，其等离子体刻蚀设备已应用在国际一线客户从 65 至 5 纳米及其他先进的集成电路加工制造生产线及先进封装生产线。根据《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年度业绩快报公告》，2025 年末，中微公司总资产约 297.72 亿元，营业收入约 123.85 亿元，归母净利润约为 21.11 亿元。中微公司在财务指标、技术引领性上均体现了大型企业的行业地位与战略价值，因此，中微公司属于大型企业。

中微半导体位于上海临港新片区，是中微公司持股 100%的全资子公司，也是中微公司在上海临港新片区建设的产业化基地及临港总部和研发中心。中微半导体在中微公司内部具有重要功能定位，其经营成果是中微公司整体经营成果的重要组成部分，因此中微半导体为大型企业中微公司的下属企业。

中微公司与发行人具备合作 3 年的基础，双方在刻蚀工艺领域开展了商业合作，具备现有合作基础，同时，根据中微公司公告披露，其产品线已涵盖先进封装 Chiplet 工艺所需的 TSV 深硅刻蚀设备、PVD 设备等，具备进一步合作的良好基础。根据发行人与中微公司、中微半导体签署的《战略合作备忘录》，各方拟就下述合作领域积极开展战略合作，重点合作领域包括但不限于：

1) 加强并深化在半导体设备领域的深度合作：发行人与中微公司、中微半导体作为半导体产业链企业，一直就半导体设备的技术研发、性能升级、产品优化等进行长期协同合作。后续各方拟通过建立共同研发沟通机制的方式，针对先进封装需求，共同开发定制化设备与工艺解决方案，包括针对发行人的三维芯片集成（2.5D/3DIC）晶圆级技术方案，为发行人优先提供对应的半导体设备解决方案，进而拓展各方的产品合作深度和广度，助力发行人亚微米互联技术、混合键合等技术储备或新技术新产品研发，共同努力在更多细分产品品类上实现合作；

2) 产业供应链本土化：中微公司、中微半导体一直与发行人共同合作配合，努力挖掘国内半导体产业链各设备上下游的零部件供应商企业，协同构建本土化供应链体系，共同推动设备与封装工艺的国产化适配，降低外部供应链依赖风险，共同积极推动集成电路产业链零部件本土化的进程。

中微公司属于半导体设备领域的大型企业，中微公司在财务指标、技术引领性上均体现了大型企业的行业地位与战略价值。中微公司产品线涵盖先进封装的关键设备，其产品与发行人工艺环节具备协同性，伴随发行人产能扩充，双方存在扩大合作及优先合作的契机。因此，双方存在坚实的合作基础，以及未来扩大合作和优先合作的业务基础，上述《战略合作备忘录》的具体内容切实可行，所约定的战略合作条款具备在限售期内落地执行的有效基础。

因此，中微半导体属于与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业的下属企业，符合《发行承销实施细则》第四十一条第（一）项的规定，具有参与本次战略配售的资格。

根据中微半导体出具的承诺函：1) 其具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序，参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域，不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其章程禁止或限制参与本次战略配售的情形；2) 其为本次战略配售股票的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；3) 其具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量/金额的发行人股票。

（5）参与战略配售的认购资金来源

根据中微半导体出具的承诺函，其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金，且符合该资金的投资方向。经核查中微半导体截至 2025 年 9 月 30 日的

财务报表，中微半导体的流动资产足以覆盖其与发行人签署的配售协议中约定的承诺认购金额。

3、上海天数智芯半导体股份有限公司

(1) 基本情况

根据天数智芯的《营业执照》、公司章程等资料及天数智芯的确认，并经本所律师于国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，天数智芯的基本信息如下：

公司名称	上海天数智芯半导体股份有限公司
成立时间	2015年12月29日
统一社会信用代码	91320114MA1MDG5R6Y
法定代表人	盖鲁江
注册资本	25,431.7736 万元人民币
注册地址	上海市闵行区陈行公路 2168 号 3 幢 101 室
经营范围	一般项目：集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子产品销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经本所律师核查，天数智芯系依法成立的股份有限公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形。

(2) 股权结构和实际控制人

根据《上海天数智芯半导体股份有限公司招股说明书》等资料，天数智芯为香港联合交易所主板上市公司，股票代码为 09903.HK。截至 2025 年 6 月 30 日，上海曦识企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海溢识企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海溯识商务咨询合伙企业（有限合伙）、上海纳识商务咨询合伙企业（有限合伙）、上海悦识企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海源识企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海琼羽商务咨询合伙企业（有限合伙）及上海数麒商务咨询有限公司（以下简称“持股平台”）构成天数智芯的单一最大股东集团。根据《上海天数智芯半导体股份有限公司招股说明书》，截至 2025 年 12 月 20 日，天数智芯的前十大股东如下所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	持股平台	54,034,125	23.61
2	大钲资本实体	52,452,943	22.92

3	海南数芯实体	17,194,091	7.51
4	沅柏资本实体	8,592,981	3.75
5	星纳赫实体	7,465,389	3.26
6	Jupiter Technology Link Investment Company Ltd	7,166,801	3.13
7	余姚碧江盛兴管理咨询合伙企业（有限合伙）	6,775,509	2.96
8	北京中关村科学城科技成长投资合伙企业（有限合伙）	5,946,308	2.60
9	上海卉岳商务咨询合伙企业（有限合伙）	5,425,000	2.37
10	熙诚致远实体	5,305,556	2.32

注：大钲资本实体包括福建大钲一期投资合伙企业（有限合伙）、南京优响股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门钲美企业管理合伙企业（有限合伙）、Masterwork Holdings Limited；海南数芯实体包括日照天芯信息技术合伙企业（有限合伙）、日照培勤信息技术合伙企业（有限合伙）；沅柏资本实体包括天津海河沅柏产业投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖旷运人工智能产业投资基金（有限合伙）、深圳市数字未来私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）；星纳赫实体包括南京星纳赫源创业投资合伙企业（有限合伙）、南京星纳峰企业管理合伙企业（有限合伙）、FOCUSTAR CAPITAL INVESTMENT FUND L.P.、XN Speed International Limited；熙诚致远实体包括北京瑞沣股权投资基金（有限合伙）、熙诚致远数字动力精选（北京）投资中心（有限合伙）。

（3）关联关系

经本所律师核查，并经天数智芯确认，天数智芯与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

（4）战略配售资格

根据天数智芯的确认，天数智芯为香港联合交易所有限公司主板上市公司，提供针对不同行业的通用 GPU 产品及 AI 算力解决方案，是中国领先的通用 GPU 芯片及 AI 算力系统提供商，也是国内首家实现训练与推理通用 GPU 芯片量产的企业。根据《上海天数智芯半导体股份有限公司招股说明书》，截至 2025 年 6 月 30 日，天数智芯资产总额 35.61 亿元，2024 年度和 2025 年 1-6 月分别实现营业收入 5.40 亿元和 3.24 亿元。

因此，天数智芯为大型企业。

根据发行人与天数智芯签署的《战略合作备忘录》，双方拟就以下领域积极开展战略合作，重点合作领域包括但不限于：

1) 发挥各自优势，实现业务互补。依托天数智芯在 GPGPU 领域的自主设计能力，针对先进封装场景优化芯片设计等完整性方案。发行人在先进封装领域的技术积累，为 GPU 芯片定制高密度互联、高散热封装方案，突破单芯片算力密度，实现战略互补。在技术指标、商务条件、交付保障等综合条件相当的情况下，天数智芯将发行人作为先进封装服务的核心优先合作方，覆盖现有量产产品、在研项目及未来新增 GPGPU 芯片封装需求。

2) 生态伙伴拓展与共创共享。联合拓展硬件厂商、解决方案提供商等生态伙伴，推动“通用 GPU+先进封装”方案在更多行业落地；共同举办技术研讨会、产品发布会，提升生态影响力。对于符合双方发展方向的生态合作机会，将优先考虑与彼此及生态伙伴共同推进，实现多方共赢。

3) 赋能数字经济算力底座升级。通过芯片设计与先进封装的深度融合，持续提升通用 GPU 算力密度、能效比与可靠性，为各行各业转型提供高性价比、自主可控的算力硬件支撑。

天数智芯的主要产品 GPGPU 芯片需要芯粒多芯片集成封装等先进封装技术来实现支撑性能升级，而发行人在芯粒多芯片集成封装等先进封装技术上国内领先，因此，双方存在坚实的合作基础，以及未来扩大合作和优先合作的业务基础，上述《战略合作备忘录》的具体内容切实可行，所约定的战略合作条款具备在限售期内落地执行的有效基础。

因此，天数智芯属于与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业，符合《发行承销实施细则》第四十一条第（一）项的规定，具有参与本次战略配售的资格。

根据天数智芯出具的承诺函：1) 其具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序，参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域，不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其章程禁止或限制参与本次战略配售的情形；2) 其为本次战略配售股票的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；3) 其具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量/金额的发行人股票。

(5) 参与战略配售的认购资金来源

根据天数智芯出具的承诺函，其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金，且符合该资金的投资方向。经核查天数智芯截至 2025 年 6 月 30 日的财务报表，天数智芯的流动资产足以覆盖其与发行人签署的配售协议中约定的承诺认购金额。

4、北京摩笔生成科技有限公司

(1) 基本情况

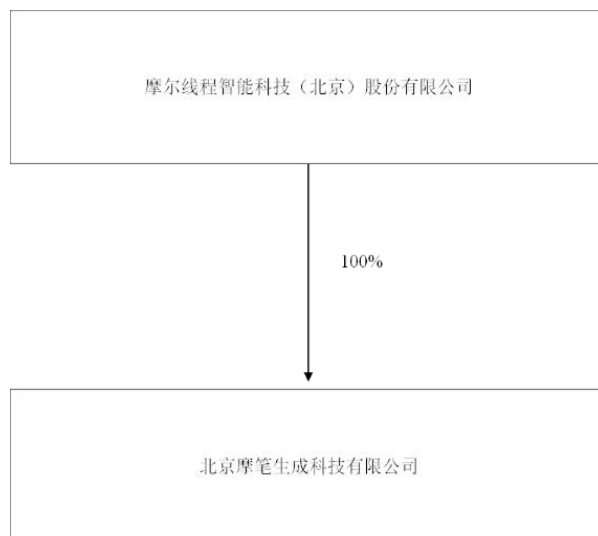
根据摩笔生成的《营业执照》、公司章程等资料及摩笔生成的确认，并经本所律师于国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，摩笔生成的基本信息如下：

公司名称	北京摩笔生成科技有限公司
成立时间	2023 年 12 月 18 日
统一社会信用代码	91110108MAD78RK79E
法定代表人	方朝霞
注册资本	26,500 万元人民币
注册地址	北京市石景山区和平西路 60 号院 1 号楼 15 层 1501-19
经营范围	许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件外包服务；数字文化创意软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字创意产品展览展示服务；数字广告制作；数字广告设计、代理；数字广告发布；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能硬件销售；数字文化创意技术装备销售；电子产品销售；云计算装备技术服务；云计算设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经本所律师核查，摩笔生成系依法成立的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形。

(2) 股权结构和实际控制人

根据摩笔生成的公司章程及摩笔生成的确认，截至本法律意见书出具之日，摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“**摩尔线程**”）持有摩笔生成100%股权，为摩笔生成的控股股东与实际控制人。摩笔生成的股权结构如下所示：



根据《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》等资料，摩尔线程为上海证券交易所科创板上市公司，股票代码为688795.SH。截至2025年12月4日，摩尔线程公司无单一持股30%以上的股东、无控股股东，实际控制人为张建中，前十大股东如下：

序号	股东名称（全称）	持股数量（股）	持股比例（%）
1	南京神傲管理咨询合伙企业（有限合伙）	58,186,082	12.3793
2	张建中	44,242,122	9.4127
3	杭州华傲管理咨询合伙企业（有限合伙）	26,927,569	5.7289
4	深圳明皓企业管理合伙企业（有限合伙）	19,922,698	4.2386
5	盛芯启程私募投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	19,588,689	4.1676
6	宁波梅山保税港区红杉优品投资管理合伙企业（有限合伙）	19,154,406	4.0752
7	沛县乾曜兴科技合伙企业（有限合伙）	16,998,680	3.6165
8	芜湖闻名泉丰投资管理合伙企业（有限合伙）	11,555,696	2.4585
9	北京中移数字新经济产业基金合伙企业（有限合伙）	8,495,555	1.8075
10	杭州京傲管理咨询合伙企业（有限合伙）	8,042,239	1.7110

（3）关联关系

经本所律师核查，并经摩笔生成确认，摩笔生成与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

（4）战略配售资格

根据摩笔生成的确认，摩笔生成是摩尔线程的全资子公司。摩尔线程为上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市公司，以自主研发的全功能 GPU 为核心，致力于为 AI、数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台，摩尔线程在 AI 智算集群、高性能图形工作站及消费电子等领域已建立一定的市场地位。根据《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 2025 年度业绩快报公告》，截至 2025 年 12 月 31 日，摩尔线程资产总额约 153.08 亿元，2025 年度实现营业收入约 15.06 亿元。因此，摩尔线程属于大型企业。

摩笔生成是摩尔线程下属的重要运营主体，专注于科技推广和应用服务业，在人工智能、软件开发、数据处理等多个领域展现出了积极的发展态势，目前有摩笔马良、摩笔天书以及 musachat 等多款 AI 应用。摩尔线程持有摩笔生成 100% 的股权，因此，摩笔生成成为大型企业摩尔线程的下属企业。

根据发行人与摩尔线程、摩笔生成签署的《战略合作备忘录》，通过本次战略配售，摩尔线程、摩笔生成与发行人可构建长期、稳定、互信的产业伙伴关系。各方拟就下述合作领域积极开展战略合作，重点合作领域包括但不限于：

1) 全功能 GPU 芯片封装测试领域的深度合作：摩尔线程将在全功能 GPU 芯片的研发、验证与量产等诸多方面与发行人进行深度合作，包括：a) 现有 GPU FCBGA 封装形式的量产验证；b) 先进封装：中大尺寸 2.5D 的产品验证与量产；c) 未来在 3DIC Die-to-wafer hybrid bonding 新技术的研发，摩尔线程可提供技术共研与新产品平台进行技术验证。

2) 国产化供应链持续稳步发展：摩尔线程与发行人建立稳定保质保量的供应链合作关系，同等情况下摩尔线程将优先支持采购发行人的产品，为摩尔线程大规模量产芯片持续稳定地供货，加速新产品的市场拓展，使得发行人优先成为摩尔线程未来在国内高可靠性和高稳定性的战略供应商。

3) 国产化产业链上下游拉通：摩尔线程通过拉通整合全国国产化产业链上下游的资源，可为发行人提供新产品平台验证与产品测试应用场景，同时也可发

行人提供国内外领先的市场、渠道、技术等战略性资源，促进双方市场拓展及供应链优化，推动实现双方的协同共赢发展。

摩尔线程的主要产品全功能 GPU 芯片需要 FCBGA、2.5D、3DIC 等先进封装技术来实现支撑性能升级，而发行人在上述先进封装技术上国内领先，因此，双方存在坚实的合作基础，以及未来扩大合作和优先合作的业务基础，上述《战略合作备忘录》的具体内容切实可行，所约定的战略合作条款具备在限售期内落地执行的有效基础。

因此，摩笔生成属于与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业的下属企业，符合《发行承销实施细则》第四十一条第（一）项的规定，具有参与本次战略配售的资格。

根据摩笔生成出具的承诺函：1）其具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序，参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域，不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其章程禁止或限制参与本次战略配售的情形；2）其为本次战略配售股票的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；3）其具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量/金额的发行人股票。

（5）参与战略配售的认购资金来源

根据摩笔生成出具的承诺函，其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金，且符合该资金的投资方向。经核查摩笔生成截至 2026 年 2 月 28 日的财务报表，摩笔生成的流动资产足以覆盖其与发行人签署的配售协议中约定的承诺认购金额。

5、沐曦数智（上海）科技有限公司

（1）基本情况

根据沐曦数智的《营业执照》、公司章程等资料及沐曦数智的确认，并经本所律师于国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，沐曦数智的基本信息如下：

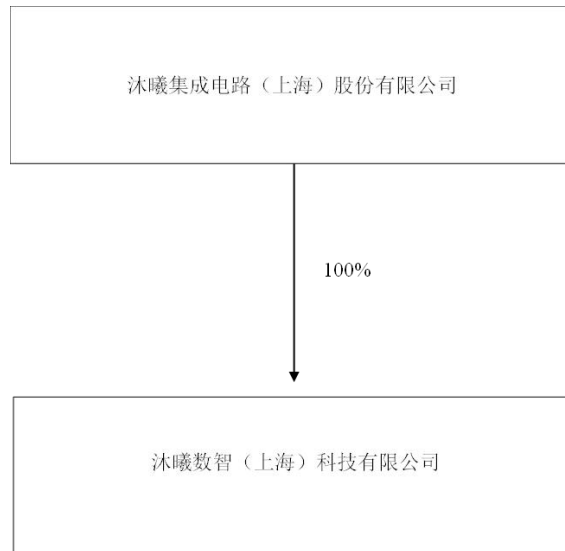
公司名称	沐曦数智（上海）科技有限公司
------	----------------

成立时间	2026年1月20日
统一社会信用代码	91310115MAK60PWE54
法定代表人	陈维良
注册资本	10,000 万元人民币
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26 号 108 室
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：集成电路设计；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发。

经本所律师核查，沐曦数智系依法成立的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形。

（2）股权结构和实际控制人

根据沐曦数智的公司章程等资料以及沐曦数智的确认，截至本法律意见书出具之日，沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“沐曦股份”）持有沐曦数智 100% 股权，为沐曦数智的控股股东、实际控制人。沐曦数智的股权结构如下所示：



根据《沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》等资料，沐曦股份为上海证券交易所科创板上市公司，股票代码为 688802.SH。截至 2025 年 12 月 16 日，沐曦股份无单一持股 30% 以上的股东，控股股东为上海骄迈企业咨询合伙企业（有限合伙），实际控制人为陈维良，前十大股东如下：

序号	股东名称（全称）	持股数量（股）	持股比例（%）
1	上海骄迈企业咨询合伙企业（有限合伙）	47,871,181	11.96
2	陈维良	20,129,832	5.03
3	上海曦骥企业咨询合伙企业（有限合伙）	14,567,737	3.64
4	和利创业投资管理（苏州）有限公司 - 南京和利国信智芯股权投资合伙企业（有限合伙）	14,378,866	3.59
5	葛卫东	14,338,176	3.58
6	上海混沌投资（集团）有限公司	12,599,744	3.15
7	深圳市瀚辰创业投资基金合伙企业（有限合伙）	12,504,050	3.13
8	上海浦东引领区投资中心（有限合伙）	9,659,452	2.41
9	南京经乾二号股权投资合伙企业（有限合伙）	8,333,860	2.08
10	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	7,040,507	1.76

（3）关联关系

经本所律师核查，并经沐曦数智确认，沐曦数智与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

（4）战略配售资格

根据沐曦数智的确认，沐曦数智是沐曦股份的全资子公司。沐曦股份为上交所科创板上市公司，主营业务是研发、设计和销售应用于人工智能训练和推理、通用计算与图形渲染领域的全栈 GPU 产品，并围绕 GPU 芯片提供配套的软件栈与计算平台，沐曦股份已成为了国内少数几家系统掌握了高性能 GPU 芯片及其基础系统软件研发、设计和量产技术的企业之一。

根据《沐曦集成电路（上海）股份有限公司 2025 年年度业绩快报》，截至 2025 年 12 月 31 日，沐曦股份资产总额约 136.74 亿元，2025 年度实现营业收入约 16.44 亿元。因此，沐曦股份为大型企业。

沐曦数智是沐曦股份的全资子公司，作为沐曦股份对外投资与产业布局的重要平台，专注围绕沐曦股份主业，系统性布局产业链上下游优质资源与关键环节。因此，沐曦数智为大型企业的下属企业。

根据发行人与沐曦股份、沐曦数智签署的《战略合作备忘录》，通过本次战略配售，沐曦数智将代表沐曦整体 GPU 业务板块，与发行人构建长期、稳定、互信的产业伙伴关系。各方拟就下述合作领域积极开展战略合作，重点合作领域包括但不限于：

1) 沐曦股份具备全栈 GPU 设计能力，而沐曦数智作为其战略协同平台，将牵头组织与发行人在技术路线图上的早期对接与联合开发。沐曦股份、沐曦数智与发行人围绕 HBM 集成、芯粒互连、热管理等关键技术开展联合攻关，通过“芯片-封装”协同设计，共同突破国产高性能 GPU 的性能与良率瓶颈，加速实现技术自主与产品迭代。

2) 沐曦数智代表沐曦股份体系坚定选择发行人作为核心封测合作伙伴。基于双方在智能计算领域的战略共识与技术互补优势，沐曦数智承诺：在同等商业条件及技术规格下，沐曦数智会优先支持发行人成为沐曦股份 GPU 产品的首选封测供应商。

沐曦股份的主要产品 GPU 芯片需要芯粒多芯片集成封装等先进封装技术来实现支撑性能升级，而发行人在芯粒多芯片集成封装等先进封装技术上国内领先，因此，双方存在坚实的合作基础，以及未来扩大合作和优先合作的业务基础，上述《战略合作备忘录》的具体内容切实可行，所约定的战略合作条款具备在限售期内落地执行的有效基础。

因此，沐曦数智属于与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业的下属企业，符合《发行承销实施细则》第四十一条第（一）项的规定，具有参与本次战略配售的资格。

根据沐曦数智出具的承诺函：1) 其具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序，参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域，不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其章程禁止或限制参与本次战略配售的情形；2) 其为本次战略配售股票的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；3) 其具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量/金额的发行人股票。

(5) 参与战略配售的认购资金来源

根据沐曦数智出具的承诺函，其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金，且符合该资金的投资方向。经核查沐曦数智截至 2026 年 2 月 28 日的财务报表，沐曦数智的流动资产足以覆盖其与发行人签署的配售协议中约定的承诺认购金额。

6、北京电控产业投资有限公司

(1) 基本情况

根据电控产投的《营业执照》、公司章程等资料及电控产投的确认，并经本所律师于国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，电控产投的基本信息如下：

公司名称	北京电控产业投资有限公司
成立时间	2008 年 10 月 30 日
统一社会信用代码	91110105681951767F
法定代表人	吕延强
注册资本	185,670.66 万元人民币
注册地址	北京市朝阳区三里屯西五街 5 号 C 区 5 层 502
经营范围	投资及投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

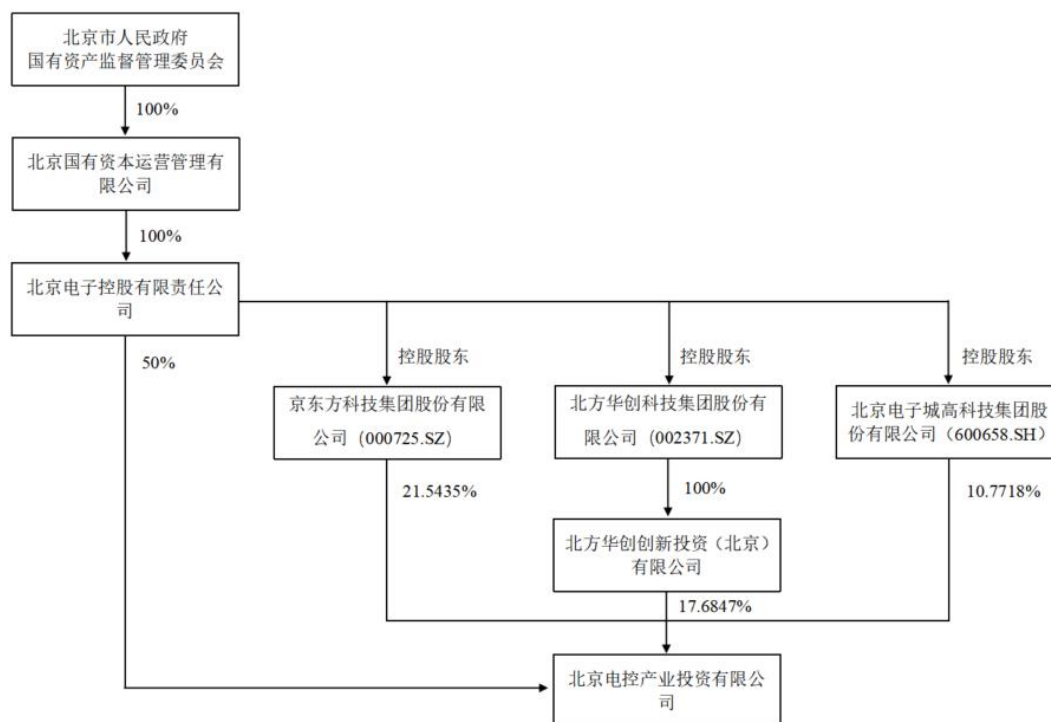
经本所律师核查，电控产投系依法成立的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形。

(2) 股权结构和实际控制人

根据电控产投的公司章程等资料及电控产投的确认，并经本所律师于国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，截至本法律意见书出具之日，北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）直接持有电控产投 50% 的股权，并为电控产投其余股东京东方科技集团股份有限公司（000725.SZ）、北京电子城高科技集团股份有限公司（600658.SH）、北方华创创新投资（北京）有限公司的控股股东；其中，北方华创创新投资（北京）有限公司为北方华创科技集团股份有限公司（002371.SZ）的全资子公司，北京电控为北方华创科技集团股份有限公司的控股股东，因此，北京电控为电控产投的控股股东。此外，北京电控

为北京国有资本运营管理有限公司的全资子公司，北京市人民政府国有资产监督管理委员会通过 100% 持有北京国有资本运营管理有限公司的股权进而间接 100% 持有北京电控的股份，因此，北京市人民政府国有资产监督管理委员会为电控产投的实际控制人。

电控产投的股权结构如下所示：



(3) 关联关系

经本所律师核查，并经电控产投确认，电控产投与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

(4) 战略配售资格

根据电控产投的确认，电控产投的控股股东为北京电控。北京电控是北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“**北京市国资委**”）授权的以电子信息产业为主业的国有特大型高科技产业集团，旗下企业从事产业涵盖半导体显示、集成电路装备、集成电路制造、智能装备、仪器仪表、新能源、信息服务、科技服务等领域。根据公开信息披露，截至 2024 年年末，北京电控总资产 5,534.38 亿元；2024 年全年营业收入 2,354.36 亿元，归属母公司股东的净利润 13.38 亿元，属于大型企业。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”，股票代码为002371.SZ）是北京电控在半导体设备领域的重要布局，北京电控通过直接持股北方华创并通过全资子公司北京七星华电科技集团有限责任公司成为北方华创的实际控制人。北方华创是国内领先的半导体设备平台型企业，在半导体装备业务板块，北方华创的主要产品包括刻蚀、薄膜沉积、热处理、湿法、离子注入、涂胶显影、键合等核心工艺装备，广泛应用于集成电路、功率半导体、三维集成和先进封装、化合物半导体、新型显示等制造领域，布局广泛。

电控产投系北京电控下属企业，主要负责北京电控的对外投资，属于大型企业北京电控的下属企业。

发行人与北方华创合作逾5年，已建立长期的业务合作关系。根据发行人与北京电控、电控产投、北方华创签署的《战略合作备忘录》，各方拟在以下领域进一步开展战略合作，重点合作方向包括但不限于：

1) 促进先进封装设备端国产化替代，保障供应链安全：北方华创是国内最大半导体设备平台，产品布局覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗、外延等核心工艺设备，形成一体化解决方案。北京电控在同等条件下，优先支持发行人推进设备端国产化的采购需求，加强发行人与北方华创在先进封装领域工艺和技术等方面开展合作，包括调配研发资源配合发行人新工艺开发，优化交付周期，提升售后服务等，协助发行人实现核心设备的国产化布局，增强发行人对供应链的自主可控，降低境外采购风险，助力发行人保障供应链安全。

2) 协助拓展新产品及工艺开发，实现差异化竞争优势：北京电控可根据发行人业务需求，在同等条件下，协助对接北方华创，将发行人新工艺、新应用需求与专用设备新产品、新技术开发紧密结合，进一步拓展产品合作深度和广度。促进各方形成“设备+工艺”产业链协同，助力发行人提升研发效率和工艺进步速度，在集成封装领域保持差异化竞争优势。

北方华创作为国内最大的半导体设备平台企业，设备布局广泛，为双方进一步拓展多类型半导体设备的合作空间奠定了良好条件。根据备忘录，北京电控可以协调北方华创可优先保障发行人核心设备国产化采购，并将发行人的新工艺需求与上游设备开发紧密结合，进而提升研发效率。因此，双方存在坚实的合作基础，以及未来扩大合作和优先合作的业务基础，上述《战略合作备忘录》的具体内容切实可行，所约定的战略合作条款具备在限售期内落地执行的有效基础。

因此,电控产投属于与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业的下属企业,符合《发行承销实施细则》第四十一条第(一)项的规定,具有参与本次战略配售的资格。

根据电控产投出具的承诺函:1)其具有相应合法的证券投资主体资格,参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序,参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域,不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其章程禁止或限制参与本次战略配售的情形;2)其为本次战略配售股票的实际持有人,不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形;3)其具备良好的市场声誉和影响力,具有较强资金实力,认可发行人长期投资价值,并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量/金额的发行人股票。

(5) 参与战略配售的认购资金来源

根据电控产投出具的承诺函,其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金,且符合该资金的投资方向。经核查电控产投截至2025年9月30日的财务报表,电控产投的流动资产足以覆盖其与发行人签署的配售协议中约定的承诺认购金额。

7、 聚辰半导体股份有限公司

(1) 基本情况

根据聚辰股份的《营业执照》、公司章程等资料及聚辰股份的确认,并经本所律师于国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询,聚辰股份的基本信息如下:

公司名称	聚辰半导体股份有限公司
成立时间	2009年11月13日
统一社会信用代码	913100006958304219
法定代表人	陈作涛
注册资本	15,827.1044 万元人民币
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区张东路1761号10幢
经营范围	集成电路产品的设计、研发、制造(委托加工),销售自产产品;上述产品同类商品的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);以及其他相关技术方案服务及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经本所律师核查，聚辰股份系依法成立的股份有限公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形。

（2）股权结构和实际控制人

根据《聚辰半导体股份有限公司 2025 年第三季度报告》等资料，聚辰股份为上海证券交易所科创板上市公司，股票代码为 688123.SH。截至 2025 年 9 月 30 日，聚辰股份的前十大股东如下所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	上海天壕科技有限公司	33,414,920	21.11
2	宁波亦鼎创业投资合伙企业（有限合伙）	7,326,843	4.63
3	香港中央结算有限公司	6,682,294	4.22
4	武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	4,124,125	2.61
5	北京珞珈天壕投资中心（有限合伙）	4,124,110	2.61
6	聚辰半导体（香港）有限公司	3,066,986	1.94
7	宁波梅山保税港区登矽全投资管理合伙企业（有限合伙）	2,909,124	1.84
8	招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	1,535,370	0.97
9	中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金	1,446,370	0.91
10	罗宾木业有限公司	1,390,900	0.88

根据《聚辰半导体股份有限公司 2025 年半年度报告》《聚辰半导体股份有限公司 2024 年年度报告》及公开信息披露，截至 2025 年 9 月 30 日，聚辰股份的控股股东为上海天壕科技有限公司，实际控制人为陈作涛。

（3）关联关系

经本所律师核查，并经聚辰股份确认，聚辰股份与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

（4）战略配售资格

根据聚辰股份的确认，聚辰股份为上海证券交易所科创板上市公司，主要产品包括存储类芯片、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片，广泛应用于内存模组、智能手机摄像头模组、汽车电子、液晶面板、工业控制、通讯、蓝牙模块、计算机及周边、白色家电、医疗仪器等众多领域。聚辰股份已占据 DDR5 SPD 存储产品领域的先发优势并实现了在相关细分市场的领先地位，在摄像头模组芯片中音

圈马达驱动芯片产品领域已经能够满足中高端及旗舰智能手机的市场需求。根据《聚辰股份 2025 年度业绩快报公告》，截至 2025 年 12 月 31 日，聚辰股份资产总额 26.78 亿元，2025 年度实现营业收入 12.21 亿元，归母净利润 3.63 亿元。因此，聚辰股份为大型企业。

发行人与聚辰股份合作逾 5 年，发行人持续向聚辰股份的音圈马达驱动芯片、EEPROM 等存储芯片提供晶圆级封装服务和中段硅片加工服务。

根据发行人与聚辰股份签署的《战略合作备忘录》，双方拟就下述合作领域积极开展战略合作，重点合作领域包括但不限于：

1) 在现有大量汽车电子和工控芯片的测试合作基础上，从广度和深度上进一步加强合作。聚辰股份将扩大与发行人在存储产品线的合作，充分借助发行人在专业的测试能力和代工品质，同时聚辰股份在新一代 SPD 产品上继续强化跟发行人的协同关系，共同打造有竞争力的产品。在同等条件的情况下，聚辰股份将发行人作为核心优先合作供应商，优先向发行人采购先进封装服务。

2) 在现有大量 Lens driver 芯片与发行人在 WLCSP 领域的深厚合作关系基础上，聚辰股份将大力拓展产品线，特别是 OIS 产品线与发行人在 WLCSP 领域的合作。未来随着 SOC 产品的集成度提高，聚辰股份对 WLCSP 的晶圆片数需求量也成倍增长。在同等条件的情况下，聚辰股份将发行人作为核心优先合作供应商，优先向发行人采购先进封装服务。

3) 聚辰股份在未来对 die TVS 先进封装有很大需求的背景下，将优先与发行人建立合作关系并支持采购，加大研发力度，共同构筑技术护城河。

聚辰股份的主要产品 EEPROM 存储芯片、镜头驱动芯片等需要晶圆级封装、中段硅片加工等先进封装技术来实现支撑性能升级，而发行人在晶圆级封装、中段硅片加工等技术上国内领先，双方存在坚实的合作基础以及未来扩大合作和优先合作的业务基础，上述《战略合作备忘录》的具体内容切实可行，所约定的战略合作条款具备在限售期内落地执行的有效基础。

因此，聚辰股份属于与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业，符合《发行承销实施细则》第四十一条第（一）项的规定，具有参与本次战略配售的资格。

根据聚辰股份出具的承诺函：1) 其具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序，参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域，不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证

券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其章程禁止或限制参与本次战略配售的情形；2) 其为本次战略配售股票的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；3) 其具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量/金额的发行人股票。

(5) 参与战略配售的认购资金来源

根据聚辰股份出具的承诺函，其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金，且符合该资金的投资方向。经核查聚辰股份截至 2025 年 9 月 30 日的财务报表，聚辰股份的流动资产足以覆盖其与发行人签署的配售协议中约定的承诺认购金额。

8、上海复旦微电子集团股份有限公司

(1) 基本情况

根据复旦微电的《营业执照》、公司章程等资料及复旦微电的确认，并经本所律师于国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，复旦微电的基本信息如下：

公司名称	上海复旦微电子集团股份有限公司
成立时间	1998 年 7 月 10 日
统一社会信用代码	91310000631137409B
法定代表人	张卫
注册资本	8,214.273 万元人民币
注册地址	上海市邯郸路 220 号
经营范围	电子产品、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，生产微电子产品，销售自产产品，并提供相关服务，投资举办符合国家高新技术产业目录的项目（具体项目另行报批）。

经本所律师核查，复旦微电系依法成立的股份有限公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形。

(2) 股权结构和实际控制人

根据《上海复旦微电子集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》等资料，复旦微电为上海证券交易所科创板和香港联合交易所主板上市公司，股份代码分别为 688385.SH 和 1385.HK。截至 2025 年 9 月 30 日，复旦微电的前十大股东如下所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	香港中央结算（代理人）有限公司	284,260,830	34.61
2	上海复芯凡高集成电路技术有限公司	106,730,000	12.99
3	上海复旦复控科技产业控股有限公司	101,732,384	12.38
4	上海本政企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	20,783,465	2.53
5	中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	7,317,733	0.89
6	施雷	7,210,000	0.88
7	蒋国兴	7,210,000	0.88
8	香港中央结算有限公司	6,804,268	0.83
9	中国农业银行股份有限公司—南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	6,422,734	0.78
10	中国农业银行股份有限公司—易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,734,652	0.58

根据《上海复旦微电子集团股份有限公司 2025 年半年度报告》《上海复旦微电子集团股份有限公司 2024 年年度报告》及公开信息披露，截至 2025 年 9 月 30 日，复旦微电无控股股东及实际控制人。

（3）关联关系

经本所律师核查，并经复旦微电确认，复旦微电与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

（4）战略配售资格

根据复旦微电的确认，复旦微电是为上交所科创板和香港联交所主板上市公司，是从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，并为客户提供系统解决方案的专业公司，复旦微电在安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA 芯片和集成电路测试服务等领域已具备较强的技术、研发优势。根据《上海复旦微电子集团股份有限公司 2025 年度业绩快报公告》，截至 2025 年 12 月 31 日，复旦微电的资产总额约 91.97 亿元，2025 年度实现营业收入约 39.82 亿元，归母净利润约 2.32 亿元。因此，复旦微电为大型企业。

根据发行人与复旦微电签署的《战略合作备忘录》，双方拟就下述合作领域积极开展战略合作，重点合作领域包括但不限于：

1) 在研发合作方面，双方精准互补。双方将重点围绕 FPGA 与人工智能芯片形成“芯片设计+先进封测”深度协同，聚焦高性能、高可靠、全国产场景，构建从设计、封测到量产的全链条合作体系。复旦微电与发行人在高端芯片封装环节开展深度合作，双方通过在芯片集成工艺与先进封装等领域开展合作研发，共同提升技术创新能力与产业化竞争力，探索出国产化高端算力芯片的发展路径。

2) 复旦微电重点在超大规模 FPGA 和 FPAI 人工智能芯片封测领域，针对高逻辑密度、高可靠性、高速接口需求，优先采用发行人芯粒多芯片集成等先进封装工艺，加强先进制程芯片的封测适配，优化产品的良率与可靠性，加快发行人芯粒多芯片集成工艺的产业化迭代，强化高端封测的自主可控能力，拓宽国内半导体产业链护城河。

复旦微电的主要产品超大规模集成电路，尤其是超大规模 FPGA 和 FPAI 人工智能芯片，需要芯粒多芯片集成封装等先进封装技术来实现支撑性能升级，而发行人在芯粒多芯片集成封装等先进封装技术上国内领先，因此，双方存在坚实的合作基础，以及未来扩大合作和优先合作的业务基础，上述《战略合作备忘录》的具体内容切实可行，所约定的战略合作条款具备在限售期内落地执行的有效基础。

因此，复旦微电属于与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业，符合《发行承销实施细则》第四十一条第（一）项的规定，具有参与本次战略配售的资格。

根据复旦微电出具的承诺函：1) 其具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序，参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域，不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其章程禁止或限制参与本次战略配售的情形；2) 其为本次战略配售股票的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；3) 其具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量/金额的发行人股票。

（5）参与战略配售的认购资金来源

根据复旦微电出具的承诺函，其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金，且符合该资金的投资方向。经核查复旦微电截至 2025 年 9 月 30 日的财务报表，复旦微电的流动资产足以覆盖其与发行人签署的配售协议中约定的承诺认购金额。

9、联芸科技（杭州）股份有限公司

（1）基本情况

根据联芸科技的《营业执照》、公司章程等资料及联芸科技的确认，并经本所律师于国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，联芸科技的基本信息如下：

公司名称	联芸科技（杭州）股份有限公司
成立时间	2014年11月7日
统一社会信用代码	91330100320508065U
法定代表人	李国阳
注册资本	46,000 万元人民币
注册地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 459 号 C 楼 C1-604 室
经营范围	技术开发、技术服务、成果转化；集成电路、计算机软件；生产：计算机软件产品；销售自产产品；批发：电子产品、集成电路应用产品、模块电子终端产品、机电设备、计算机软硬件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（涉及许可证的凭证经营，国家禁止和限制的除外）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经本所律师核查，联芸科技系依法成立的股份有限公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形。

（2）股权结构和实际控制人

根据《联芸科技（杭州）股份有限公司 2025 年第三季度报告》等资料，联芸科技为上海证券交易所科创板上市公司，股票代码为 688449.SH。截至 2025 年 9 月 30 日，联芸科技的前十大股东如下所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	杭州弘菱投资合伙企业（有限合伙）	87,400,432	19.00
2	杭州海康威视数字技术股份有限公司	80,751,886	17.55
3	杭州海康威视科技有限公司	53,828,336	11.70
4	杭州同进投资管理合伙企业（有限合伙）	30,263,308	6.58
5	方小玲	30,263,308	6.58
6	国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司-国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	17,267,033	3.75

7	西藏远识创业投资管理有限公司	15,428,587	3.35
8	杭州芯享股权投资合伙企业（有限合伙）	14,868,817	3.23
9	西藏鸿胤企业管理服务有限公司	13,994,157	3.04
10	长存资本（武汉）投资管理有限公司	10,212,766	2.22

根据《联芸科技（杭州）股份有限公司 2025 年半年度报告》《联芸科技（杭州）股份有限公司 2024 年年度报告》及公开信息披露，截至 2025 年 9 月 30 日，联芸科技无控股股东，联芸科技实际控制人为方小玲。

（3）关联关系

经本所律师核查，并经联芸科技确认，联芸科技与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

（4）战略配售资格

根据联芸科技的确认，联芸科技为上海证券交易所科创板上市公司，是一家提供数据存储主控芯片、AIoT 信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业。联芸科技已发展成为全球出货量排名前列的独立 SSD 主控芯片厂商，是全球为数不多掌握数据存储主控芯片核心技术的企业之一。根据《联芸科技 2025 年度业绩快报公告》，截至 2025 年 12 月 31 日，联芸科技资产总额 23.32 亿元，2025 年度实现营业收入 13.31 亿元，归母净利润 1.42 亿元。因此，联芸科技为大型企业。

发行人与联芸科技合作逾 5 年，发行人持续向联芸科技的存储主控芯片提供中段硅片加工服务。

根据发行人与联芸科技签署的《战略合作备忘录》，双方拟就下述合作领域积极开展战略合作，重点合作领域包括但不限于：

1) 在现有中段硅片加工业务合作基础上，未来，双方根据各自业务需求将继续推进在中段硅片加工业务领域的合作规模，并基于发行人核心产品线的迭代升级与产能扩张，联芸科技将结合自身业务需求，加大双方 FT/SLT 业务领域的合作规模，在同等条件的情况下，联芸科技将发行人作为核心优先合作供应商，优先向发行人采购先进封装服务。

2) 基于联芸科技在数据存储主控芯片及 AIoT 信号处理及传输芯片领域的市场及行业资源优势,联芸科技在合规基础上将积极向发行人提供新产品测试与验证机会,进一步拓展双方的产品合作深度和广度。

3) 双方将通过定期质量审核,持续推动服务质量改进,稳步提高出货产品稳定性和可靠性。

联芸科技的主要产品存储主控芯片对中段硅片加工服务存在广泛的需求,而发行人在中段硅片加工领域技术上国内领先,双方存在坚实的合作基础以及未来扩大合作和优先合作的业务基础,上述《战略合作备忘录》的具体内容切实可行,所约定的战略合作条款具备在限售期内落地执行的有效基础。

因此,联芸科技属于与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业,符合《发行承销实施细则》第四十一条第(一)项的规定,具有参与本次战略配售的资格。

根据联芸科技出具的承诺函:1)其具有相应合法的证券投资主体资格,参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序,参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域,不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其章程禁止或限制参与本次战略配售的情形;2)其为本次战略配售股票的实际持有人,不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形;3)其具备良好的市场声誉和影响力,具有较强资金实力,认可发行人长期投资价值,并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量/金额的发行人股票。

(5) 参与战略配售的认购资金来源

根据联芸科技出具的承诺函,其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金,且符合该资金的投资方向。经核查联芸科技截至 2025 年 9 月 30 日的财务报表,联芸科技的流动资产足以覆盖其与发行人签署的配售协议中约定的承诺认购金额。

10、北京昂瑞微电子技术股份有限公司

(1) 基本情况

根据昂瑞微的《营业执照》、公司章程等资料及昂瑞微的确认,并经本所律师于国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询,昂瑞微的基本信息如下:

公司名称	北京昂瑞微电子技术股份有限公司
成立时间	2012年7月3日
统一社会信用代码	9111010859966120XL
法定代表人	钱永学
注册资本	9,953.1688 万元人民币
注册地址	北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼5层101
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经本所律师核查，昂瑞微系依法成立的股份有限公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形。

（2）股权结构和实际控制人

根据《北京昂瑞微电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等公告及昂瑞微的确认，昂瑞微为上海证券交易所科创板上市公司，股票代码为 688790.SH；截至 2025 年 12 月 15 日，昂瑞微认定无控股股东，实际控制人为钱永学。截至 2025 年 12 月 15 日，昂瑞微的前十大股东如下所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	北京鑫科股权投资合伙企业（有限合伙）	6,807,932	9.1200
2	南京同芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,435,800	7.2818
3	南京创芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,231,047	7.0075
4	南京瑞达信创业投资合伙企业（有限合伙）	4,455,369	5.9684
5	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	3,107,100	4.1623
6	哈勃科技创业投资有限公司	3,107,100	4.1623
7	南京科芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,955,200	3.9588
8	广州同进实业投资合伙企业（有限合伙）	2,900,000	3.8849
9	钱永学	2,879,819	3.8578
10	宁波涌跃创业投资中心（有限合伙）	2,619,688	3.5094

（3）关联关系

经本所律师核查，并经昂瑞微确认，昂瑞微与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

（4）战略配售资格

根据昂瑞微的确认，昂瑞微为上海证券交易所科创板上市公司，主要从事射频前端芯片、射频 SoC 芯片及其他模拟芯片的研发、设计与销售，拥有基于 CMOS、GaAs、SiGe、SOI、GaN 等多种工艺的芯片设计和大规模量产经验，核心产品线涵盖三大类，超四百款芯片。从收入规模角度，昂瑞微在以发射端产品为主的国产射频前端厂商中排名前三，已经建立一定的市场地位。根据《北京昂瑞微电子技术股份有限公司 2025 年年度业绩快报》，截至 2025 年 12 月 31 日，昂瑞微资产总额 35.30 亿元，2025 年度实现营业收入 18.84 亿元。因此，昂瑞微为大型企业。

发行人与昂瑞微合作逾 2 年，发行人持续向昂瑞微的射频芯片提供中段硅片加工服务和晶圆级封装服务。

根据发行人与昂瑞微签署的《战略合作备忘录》，双方拟就下述合作领域积极开展战略合作，重点合作领域包括但不限于：

1) 昂瑞微将在符合内部制度的前提下，优先考虑将所需要的晶圆凸块加工，晶圆测试，晶圆研磨切割，晶圆卷带等封装测业务向发行人采购，加强战略合作关系。发行人也将重点开放新的封测技术支持给昂瑞微团队，同时提供有竞争力的价格、交期、品质、产能支持给昂瑞微，以深化产品代工合作，实现共赢。

2) 联合技术创新：双方作为战略合作伙伴，加强交流、深化合作，以实现联合技术创新。双方利用各自技术优势及平台资源，周期性举办技术交流会议聚焦射频前端、无线连接 SOC、模拟芯片及晶圆级封装等业务和产品领域，共同构筑高性能有竞争力的芯片，从而提升联合技术创新水平。

昂瑞微的主要产品射频芯片需要晶圆级封装、中段硅片加工等先进封装技术来实现支撑性能升级，而发行人在晶圆级封装等先进封装技术上国内领先，双方存在坚实的合作基础以及未来扩大合作和优先合作的业务基础，上述《战略合作备忘录》的具体内容切实可行，所约定的战略合作条款具备在限售期内落地执行的有效基础。

因此，昂瑞微属于与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业，符合《发行承销实施细则》第四十一条第（一）项的规定，具有参与本次战略配售的资格。

根据昂瑞微出具的承诺函：1）其具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序，参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域，不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其章程禁止或限制参与本次战略配售的情形；2）其为本次战略配售股票的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；3）其具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量/金额的发行人股票。

（5）参与战略配售的认购资金来源

根据昂瑞微出具的承诺函，其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金，且符合该资金的投资方向。经核查昂瑞微截至 2025 年 6 月 30 日的财务报表，昂瑞微的流动资产足以覆盖其与发行人签署的配售协议中约定的承诺认购金额。

11、唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

（1）基本情况

根据唯捷创芯的公司章程等资料及唯捷创芯的确认，并经本所律师于国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，唯捷创芯的基本信息如下：

公司名称	唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
成立时间	2010 年 6 月 2 日
统一社会信用代码	9112011655651308XJ
法定代表人	孙亦军
注册资本	430,313,008 元人民币
注册地址	天津开发区信环西路 19 号 2 号楼 2701-3 室
经营范围	集成电路的设计咨询、研发、测试、销售及相关技术服务；自营和代理各种货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

经本所律师核查，唯捷创芯系依法成立的股份有限公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形。

（2）股权结构和实际控制人

根据《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2025 年第三季度报告》等资料，唯捷创芯为上海证券交易所科创板上市公司，股票代码为 688153.SH。截至 2025 年 9 月 30 日，唯捷创芯的前十大股东如下所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	GaintechCo.Limited	101,247,461	23.53
2	荣秀丽	53,265,280	12.38
3	北京语越投资管理中心（有限合伙）	30,514,794	7.09
4	深圳市贵人资本投资有限公司	26,183,095	6.08
5	天津语捷科技合伙企业（有限合伙）	25,242,375	5.87
6	孙亦军	14,599,592	3.39
7	OPPO 广东移动通信有限公司	12,208,697	2.84
8	天津语尚科技合伙企业（有限合伙）	9,278,263	2.16
9	天津语腾科技合伙企业（有限合伙）	8,566,319	1.99
10	湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	6,260,867	1.45

根据《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2025 年半年度报告》《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2024 年年度报告》及公开信息披露，截至 2025 年 9 月 30 日，唯捷创芯无控股股东及实际控制人。

（3）关联关系

经本所律师核查，并经唯捷创芯确认，唯捷创芯与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

（4）战略配售资格

根据唯捷创芯的确认，唯捷创芯为上海证券交易所科创板上市公司，主营射频功率放大器模组、接收端模组等产品，广泛应用于智能手机、平板电脑、无线路由器、智能穿戴设备、车载通信系统、卫星通信终端及 AI 智能产品等终端设备。唯捷创芯能够为客户提供从 2G 至 5G 的全面射频前端解决方案，确立了在行业中的领导地位。根据《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2025 年度业绩快报公告》，截至 2025 年 12 月 31 日，唯捷创芯总资产 47.31 亿元，2025 年度实现营业收入 23.21 亿元，归母净利润 0.45 亿元。因此，唯捷创芯为大型企业。

发行人已与唯捷创芯合作逾 5 年，发行人持续向唯捷创芯的射频芯片提供晶圆级封装服务和中段硅片加工服务。

根据发行人与唯捷创芯签署的《战略合作备忘录》，双方拟就下述合作领域积极开展战略合作，重点合作领域包括但不限于：

1) 建立常态化合作机制，深化产业链协同与技术共研。双方将结合核心资源与发展需求，建立常态化合作沟通机制，充分发挥产业链上下游协同效应。唯捷创芯将和发行人共同探讨、验证新技术，评估再分布层（RDL）设计与键合工艺，共同解决封装寄生效应导致的信号损耗与发热问题，实现从“单纯代工”向“设计-工艺协同优化（DTCO）”的深度转变。并将在同等情况下，优先支持发行人进入唯捷创芯核心供应商体系。

2) 针对发行人未来拓展的先进封装业务，双方将开展前瞻性技术交流与合作探索，结合射频前端芯片特性与应用需求，共同研究工艺适配方案。

3) 紧跟射频前端模组化趋势，双方将重点开展 L-PAMiD/L-PAMiF 等高集成度模组的封装研发。基于发行人的硅基工艺优势，共同探讨攻克多芯片堆叠带来的电磁干扰（EMI）屏蔽与热应力控制难题，提升模组集成度与性能表现。

唯捷创芯的主要产品射频前端芯片拥有广泛的晶圆级封装和中段硅片加工需求，而发行人在晶圆级封装和中段硅片加工技术上国内领先，双方存在坚实的合作基础以及未来扩大合作和优先合作的业务基础，上述《战略合作备忘录》的具体内容切实可行，所约定的战略合作条款具备在限售期内落地执行的有效基础。

因此，唯捷创芯属于与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业，符合《发行承销实施细则》第四十一条第（一）项的规定，具有参与本次战略配售的资格。

根据唯捷创芯出具的承诺函：1) 其具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序，参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域，不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其章程禁止或限制参与本次战略配售的情形；2) 其为本次战略配售股票的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；3) 其具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量/金额的发行人股票。

（5）参与战略配售的认购资金来源

根据唯捷创芯出具的承诺函，其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金，且符合该资金的投资方向。经核查唯捷创芯截至 2025 年 9 月 30 日的财务报表，唯捷创芯的流动资产足以覆盖其与发行人签署的配售协议中约定的承诺认购金额。

12、上海华虹宏力半导体制造有限公司

(1) 基本情况

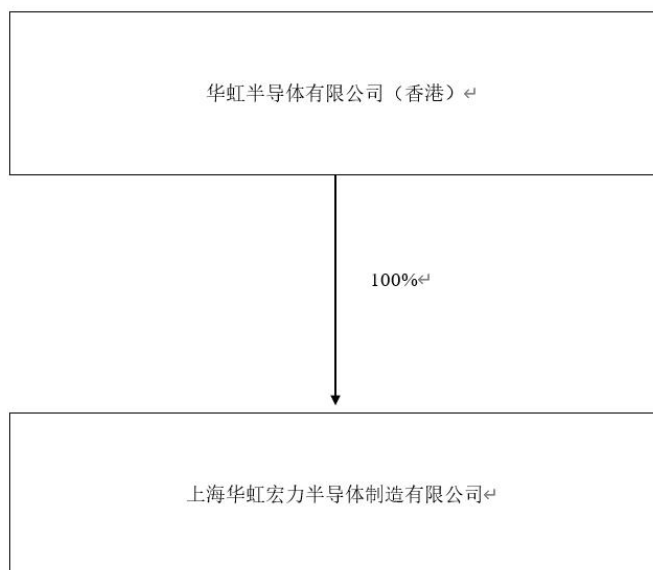
根据华虹宏力的《营业执照》、公司章程等资料及华虹宏力的确认，并经本所律师于国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，华虹宏力的基本信息如下：

公司名称	上海华虹宏力半导体制造有限公司
成立时间	2013 年 1 月 24 日
统一社会信用代码	91310000057674532R
法定代表人	白鹏
注册资本	2,046,092.7759 万元
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 1399 号
经营范围	集成电路产品有关的设计、开发、制造、测试、封装，销售集成电路产品及相关技术支持，销售自产产品。

经本所律师核查，华虹宏力系依法成立的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形。

(2) 股权结构和实际控制人

根据华虹宏力的公司章程等资料以及华虹宏力的确认，截至本法律意见书出具之日，华虹半导体有限公司（以下简称“**华虹半导体**”）持有华虹宏力 100% 股权，为华虹宏力的控股股东。华虹宏力的股权结构如下所示：



根据《华虹半导体有限公司 2025 年第三季度报告》等资料，华虹半导体为上海证券交易所科创板上市公司，股票代码为 688347.SH，并在香港联合交易所主板上市，股票代码为 01347.HK。截至 2025 年 9 月 30 日，华虹半导体的前十大股东如下所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	香港中央结算（代理人）有限公司 (HKSCCNOMINEESLIMITED)	817,719,582	47.12
2	上海华虹国际公司 (Shanghai HuaHongInternational,Inc.)	347,605,650	20.03
3	联和国际有限公司 (Sino-AllianceInternational,Ltd.)	160,545,541	9.25
4	华芯投资管理有限责任公司 - 国家 集成电路产业投资基金二期股份有 限公司	48,334,249	2.79
5	中国国有企业结构调整基金二期股 份有限公司	10,697,339	0.62
6	招商银行股份有限公司 - 银河创新 成长混合型证券投资基金	9,300,000	0.54
7	中信证券股份有限公司 - 嘉实上证 科创板芯片交易型开放式指数证券 投资基金	9,258,906	0.53
8	海通创新证券投资有限公司	8,155,000	0.47
9	国泰君安证裕投资有限公司	8,155,000	0.47
10	中国工商银行股份有限公司 - 诺安 成长混合型证券投资基金	6,391,974	0.37

根据《华虹半导体有限公司 2025 年半年度报告》《华虹半导体有限公司 2024 年年度报告》及公开信息披露，截至 2025 年 9 月 30 日，华虹半导体的直接控股股东为 Shanghai Hua Hong International, Inc.（上海华虹国际公司），间接控股股东为上海华虹（集团）有限公司，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

（3）关联关系

经本所律师核查，并经华虹宏力确认，华虹宏力与发行人、联席主承销商之间不存在其他关联关系。

（4）战略配售资格

根据华虹宏力的确认，华虹宏力是华虹半导体的全资子公司，华虹半导体是全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业，秉持“8 英寸+12 英寸”、先进“特色 IC+Power Discrete”的发展战略，为客户提供多元化的晶圆代工及配套服务。华虹半导体专注于嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理和逻辑与射频等特色工艺技术的持续创新，有力支持新能源汽车、绿色能源，物联网等新兴领域应用，同时满足汽车电子芯片生产的严苛要求。华虹半导体在上海金桥和张江建有三座 8 英寸晶圆厂，另在无锡高新技术产业开发区内建有两座全球领先的 12 英寸特色工艺晶圆厂。根据《华虹半导体有限公司 2024 年年度报告》，2024 年年末，华虹半导体的资产总额约为 879.35 亿元，并于 2024 年度实现营业收入约 143.88 亿元，归母净利润 3.81 亿元。结合上述，华虹半导体是全球领先的特色工艺晶圆代工企业，也是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业，在工艺类型、收入规模方面具备优势，因此，华虹半导体为大型企业。

华虹宏力作为华虹半导体全资子公司，是华虹半导体的核心制造平台，专注于嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理和逻辑与射频等多元化特色工艺，是国内特色工艺晶圆制造的核心产能载体。

发行人与华虹半导体在中段硅片加工业务领域具备近 5 年的业务合作基础。根据发行人与华虹半导体、华虹宏力签署的《战略合作备忘录》，各方拟就下述合作领域积极开展战略合作，包括但不限于：

1) 产业生态共建，联合拓展特色芯片市场“晶圆制造+先进封测”一体化开发、生产。华虹半导体作为前道芯片制造核心载体聚焦晶圆制造及特色工艺研发创新，发行人作为国内 12 英寸中段制造以及先进封装测试龙头，主攻凸块加工、2.5D/3D 封装、Chiplet 集成。双方将依托各自优势联合拓展市场，缩短产品导入

周期。通过战略合作形成前道制造、中段加工、先进封测的一体化协同链路，实现工艺互补、产能联动、技术共研，为芯片设计领域的共同客户联合开发高适配性、高可靠性的定制化封测方案，完成工艺验证、良率提升与量产落地，推动产业链高质量发展。

2) 产能、供应链、技术协同。华虹保障产能并提供工艺支持，发行人优先提供先进封测服务。双方联合参与客户立项、测试认证、量产导入，提供晶圆制造+先进封装全流程服务，建立产能对接、交付协同机制，保障共同客户订单稳定交付。

华虹半导体及其下属公司华虹宏力的战略价值主要体现在与发行人显著的产业链协同效应。华虹半导体及华虹宏力从事晶圆制造环节，发行人则可提供先进封测工艺，具备实现工艺互补、产能联动与技术共研的合作基础，同时，本次合作的产能保障、工艺支持更能有效加强产业链协同效应。双方存在坚实的合作基础以及未来扩大合作和优先合作的业务基础，上述《战略合作备忘录》的具体内容切实可行，所约定的战略合作条款具备在限售期内落地执行的有效基础。

因此，华虹宏力属于与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业的下属企业，符合《发行承销实施细则》第四十一条第（一）项的规定，具有参与本次战略配售的资格。

根据华虹宏力出具的承诺函：1) 其具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序，参与本次战略配售符合其投资范围和领域，不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其章程禁止或限制参与本次战略配售的情形；2) 其为本次战略配售股票的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；3) 其具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量/金额的发行人股票。

（5）参与战略配售的认购资金来源

根据华虹宏力出具的承诺函，其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金，且符合该资金的投资方向。经核查华虹宏力截至 2025 年 12 月 31 日的财务报表，华虹宏力的流动资产足以覆盖其与发行人签署的配售协议中约定的承诺认购金额。

13、翱捷科技股份有限公司

(1) 基本情况

根据翱捷科技的《营业执照》、公司章程等资料及翱捷科技的确认，并经本所律师于国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，翱捷科技的基本信息如下：

公司名称	翱捷科技股份有限公司
成立时间	2015年4月30日
统一社会信用代码	913100003326874787
法定代表人	戴保家
注册资本	41,830.0889 万元人民币
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢8层（名义楼层9层）
经营范围	从事电子、通信、网络工程、计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让和技术咨询服务，电子产品及设备、计算机软件及辅助设备的批发、零售（仅限分支机构）、进出口、佣金代理（拍卖除外）、其相关配套服务及投资咨询（除金融、证券外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经本所律师核查，翱捷科技系依法成立的股份有限公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形。

(2) 股权结构和实际控制人

根据《翱捷科技股份有限公司2025年第三季度报告》等资料，翱捷科技为上海证券交易所科创板上市公司，股票代码为688220.SH。截至2025年9月30日，翱捷科技的前十大股东如下所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	64,557,440	15.43
2	宁波捷芯睿微企业管理合伙企业（有限合伙）	38,013,676	9.09
3	戴保家	35,242,880	8.43
4	上海浦东新星纽士达创业投资有限公司	22,152,640	5.30
5	深圳市前海万容红土投资基金（有限合伙）	19,848,266	4.74
6	招商银行股份有限公司 - 银河创新成长混合型证券投资基金	12,004,873	2.87
7	GreatASR1 Limited	11,746,884	2.81
8	上海浦东新兴产业投资有限公司	9,076,160	2.17
9	香港中央结算有限公司	8,169,403	1.95

10	GreatASR2 Limited	6,710,240	1.60
----	-------------------	-----------	------

根据《翱捷科技股份有限公司 2025 年半年度报告》《翱捷科技股份有限公司 2024 年年度报告》及公开信息披露，截至 2025 年 9 月 30 日，翱捷科技无控股股东，翱捷科技实际控制人为戴保家（TAI PO KA）。

（3）关联关系

经本所律师核查，并经翱捷科技确认，翱捷科技与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

（4）战略配售资格

根据翱捷科技的确认，翱捷科技为上交所科创板上市公司，是一家提供无线通信、超大规模芯片的平台型芯片企业，同时拥有全制式蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片研发设计实力，且具备提供超大规模高速 SoC 芯片定制及半导体 IP 授权服务能力。根据业绩快报公告，截至 2025 年 12 月 31 日，翱捷科技资产总额 69.80 亿元，2025 年度实现营业收入 38.17 亿元。因此，翱捷科技为大型企业。

发行人与翱捷科技合作逾 5 年，发行人持续向翱捷科技的基带芯片、非蜂窝物联网芯片提供中段硅片加工服务和晶圆级封装服务。

根据发行人与翱捷科技签署的《战略合作备忘录》，双方拟就下述合作领域积极开展战略合作，重点合作领域包括但不限于：

1) 推进全品类产品产业链协同与深度合作

翱捷科技将强化中高端基带芯片在 FOPOP 封装领域、中低端芯片在 Bumping 和 FCCSP 封装领域，以及 CPU/GPU/存储控制器等高算力芯片在 FCBGA、2.5D 和 3D 先进封装领域的深度合作。

2) 工艺联合开发促进工艺协同与量产落地

推动芯片设计与先进封测制造高效衔接、工艺协同与量产落地，优先与发行人开展工艺联合开发及量产订单落地，进一步提升双方在无线通讯、端云智能、算力基础设施等领域的品牌影响力与市场份额，实现互利共赢、长期协同发展。

3) 深化业务往来，建立常态化业务对接机制

双方将建立常态化业务对接机制,持续深化相关领域业务往来。在技术方案、交付能力、质量与成本满足同等条件下,针对上述合作领域,翱捷科技将优先与发行人开展封测项目合作、工艺联合开发及量产订单落地,推动合作务实推进、持续落地。

翱捷科技的主要产品基带芯片和非蜂窝物联网芯片需要中段硅片加工服务和晶圆级封装服务来实现支撑性能升级,而发行人在中段硅片加工、晶圆级封装等技术上国内领先,双方存在坚实的合作基础以及未来扩大合作和优先合作的业务基础,上述《战略合作备忘录》的具体内容切实可行,所约定的战略合作条款具备在限售期内落地执行的有效基础。

因此,翱捷科技属于与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业,符合《发行承销实施细则》第四十一条第(一)项的规定,具有参与本次战略配售的资格。

根据翱捷科技出具的承诺函:1)其具有相应合法的证券投资主体资格,参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序,参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域,不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其章程禁止或限制参与本次战略配售的情形;2)其为本次战略配售股票的实际持有人,不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形;3)其具备良好的市场声誉和影响力,具有较强资金实力,认可发行人长期投资价值,并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量/金额的发行人股票。

(5) 参与战略配售的认购资金来源

根据翱捷科技出具的承诺函,其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金,且符合该资金的投资方向。经核查翱捷科技截至2025年9月30日的财务报表,翱捷科技的流动资产足以覆盖其与发行人签署的配售协议中约定的承诺认购金额。

14、中金盛合芯途共赢一号员工参与战略配售集合资产管理计划

参与本次战略配售的员工资产管理计划为中金盛合芯途共赢一号员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称“中金盛合一号资管计划”),认购上限为31,500万元。

(1) 基本情况

根据中金盛合一号资管计划的资产管理合同、备案证明等资料，并经本所律师于中国证券投资基金业协会网站（www.amac.org.cn）查询，中金盛合一号资管计划的基本信息如下：

产品名称	中金盛合芯途共赢一号员工参与战略配售集合资产管理计划
产品编码	SBPR07
管理人名称	中国国际金融股份有限公司
托管人名称	兴业银行股份有限公司
备案日期	2026年2月12日
成立日期	2026年2月10日
到期日	2036年2月10日
投资类型	权益类

（2）实际支配主体

根据《中金盛合芯途共赢一号员工参与战略配售集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“**资产管理合同**”），中金公司作为中金盛合一号资管计划的管理人享有的权利包括：1）按照资产管理合同约定，独立管理和运用中金盛合一号资管计划财产，以管理人的名义，代表中金盛合一号资管计划与其他第三方签署中金盛合一号资管计划投资文件；2）按照资产管理合同约定，及时、足额获得管理人管理费用和业绩报酬（如有）；3）按照有关规定和资产管理合同约定行使因中金盛合一号资管计划财产投资所产生的权利；4）在不损害投资者实质利益的情况下，根据管理运作实际情况对中金盛合一号资管计划的认购、参与业务规则（包括但不限于中金盛合一号资管计划总规模、单个投资者首次认购、参与金额、每次参与金额及持有的中金盛合一号资管计划总金额限制等）及其他事项进行调整或补充明确，并及时予以公告；5）自行提供或者委托经中国证券监督管理委员会、中国证券投资基金业协会认定的服务机构为中金盛合一号资管计划提供募集、份额登记、估值与核算、信息技术系统等服务，并对其行为进行必要的监督和检查；6）以管理人的名义，代表中金盛合一号资管计划行使投资过程中产生的权属登记等权利；7）按照投资者适当性管理、反洗钱、非居民金融账户涉税信息尽职调查等相关法规、监管规定和内部制度要求，对投资者进行尽职调查、审核，要求投资者签署、提交声明、告知书等相关文件，对不符合准入条件或资产管理合同约定的投资者，管理人有权拒绝接受其认购、参与申请；8）如受托财产投资出现投资标的到期无法变现、交易对手违约或其他任何争议、纠纷，管理人有权聘请律师事务所进行处理，处理前述事项的相关费用由资产管理计划受托财产承担；9）为满足及支付中金盛合一号资管计划任何应付的税款、

费用及其他负债（包括但不限于满足结算保证金金额要求等）及预留必要资金头寸之需要，中金公司有权自主处置变现中金盛合一号资管计划的非现金形式资产，包括但不限于中金公司认为适当数量的标的股票；10）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、中国证券投资基金业协会规定的及资产管理合同约定的其他权利。

基于上述，本所认为，中金盛合一号资管计划的实际支配主体为其管理人中金公司。

（3）董事会审议情况及人员构成

2025年11月17日，发行人召开第一届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售计划的议案》。

根据发行人的确认，参与本次战略配售的人员应当符合如下条件：1）公司的高级管理人员；2）公司的核心员工。其中，公司的核心员工的认定标准为：经理级别及以上管理或工程技术骨干人员。根据发行人确认，参与本次战略配售的人员均满足前述参与人员应当符合的条件，具体名单请见本法律意见书之附件1。

根据发行人确认，并经本所律师核查，参与本次战略配售的人员均与发行人的全资子公司、发行人全资子公司之分公司签署了劳动合同或劳务合同。

（4）资金来源

根据参与本次战略配售的人员签署的《资产管理合同》及《投资者承诺书》，发行人的高级管理人员与核心员工参与战略配售的认购资金均为个人自有资金，没有使用筹集的他人资金参与中金盛合一号资管计划，没有使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资。

（5）战略配售资格

根据发行人确认，并经本所律师核查，中金盛合一号资管计划的参与人员均为发行人的高级管理人员及核心员工，中金盛合一号资管计划属于“发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划”。中金盛合一号资管计划已完成备案，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格。

根据中金盛合一号资管计划的管理人中金公司出具的承诺函：1）中金盛合一号资管计划具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已经依法履

行内外部批准程序（如需），中金盛合一号资管计划参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域，不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者中金盛合一号资管计划协议或制度禁止或限制参与本次战略配售的情形；2）资产管理计划所有认购本次战略配售股票的资金来源为其合法募集的发行人高级管理人员与核心员工的自有资金，且符合该资金的投资方向。

综上，中金盛合一号资管计划符合参与战略配售的投资者选择标准和配售资格的相关规定。

同时，中金盛合一号资管计划锁定期为自发行人本次发行的股票上市之日起锁定 36 个月，其做出如下承诺：1）中金盛合一号资管计划同意最终所获配战略配售股票自本次发行的股票上市之日起锁定 36 个月；2）本员工持股计划在限售期内不会通过任何形式转让所持有本次战略配售的股票，也不会就本次战略配售的股票设置任何质押、抵押及其他权利限制，但法律法规另有规定的除外；3）中金盛合一号资管计划不参与发行人本次公开发行股票网上发行与网下发行；4）中金盛合一号资管计划承诺自发行人首次公开发行并在科创板上市之日起至本企业最终所获配战略配售股票锁定期终止之日，不会将持有的本次战略配售股票用于融券交易，不向其他机构出借持有的本次战略配售股票。

15、中国中金财富证券有限公司

（1）基本情况

根据中金财富的《营业执照》、公司章程等资料及中金财富的确认，并经本所律师于国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，中金财富的基本信息如下：

公司名称	中国中金财富证券有限公司
成立时间	2005 年 9 月 28 日
统一社会信用代码	91440300779891627F
法定代表人	王建力
注册资本	800,000 万元人民币
注册地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。
股权结构	中金公司持有 100% 股权

经本所律师核查，中金财富系依法成立的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形。

（2）关联关系

中金财富系中金公司的全资子公司；中金财富与发行人之间存在以下关系：

1) 根据《盛合晶微半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）》及发行人的确认，发行人股东启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“**中金启鹭**”）的执行事务合伙人以及中金共赢启江（上海）科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“**中金共赢**”）、苏州中金上汽新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“**中金上汽**”）、南通中金传合股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“**中金传合**”）的执行事务合伙人兼私募基金管理人为中金资本运营有限公司（以下简称“**中金资本**”）；中金祺智（上海）股权投资中心（有限合伙）（以下简称“**中金祺智**”）的执行事务合伙人兼私募基金管理人为中金私募股权投资管理有限公司（以下简称“**中金私募**”）。中金资本和中金私募均系中金公司的全资子公司。中金共赢、中金启鹭、中金上汽、中金传合及中金祺智（以下合称“**中金系股东**”）存在一致行动关系。中金公司、中金资本为发行人关联方。Auto Hub Investment Limited（以下简称“**Auto Hub**”）系中金公司的全资子公司。中金系股东及 Auto Hub 合计持有发行人 5.48% 股权。

根据中金公司于 2026 年 2 月 25 日发布的《中国国际金融股份有限公司关于盛合晶微半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的发行保荐书》（预披露），截至 2025 年 6 月 30 日，发行人股东苏州漠一策创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州元禾厚望长芯创业投资合伙企业（有限合伙）、汇芯十七期股权投资（安吉）合伙企业（有限合伙）等主体的间接出资人中包含中金公司作为执行事务合伙人控制的合伙企业或其下属企业，该等主体间接持有发行人的股份比例不足 0.2%。

2) 此外，中金系股东委派杨刘作为发行人董事，任期为自 2024 年 4 月起三年。

（3）战略配售资格

根据中金财富的确认，并经本所律师核查，中金财富系保荐人（主承销商）中金公司的全资子公司，属于“按照《发行承销实施细则》规定实施跟投的保荐

人相关子公司”，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格，符合《发行承销实施细则》第四章关于“保荐人相关子公司跟投”的相关规定。

根据中金财富出具的承诺函：1）如果发行人的发行价格（或者发行价格区间上限）超过四个值孰低值的，其承诺认购发行人本次发行的 A 股股票，按照本次发行最终确定的发行价格获得配售，具体认购金额根据最终发行规模确定；2）其具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序，参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域，不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其章程禁止或限制参与本次战略配售的情形；3）其为本次战略配售股票的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；4）其具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量/金额的发行人股票。

因此，中金财富具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格。

（4）参与战略配售的认购资金来源

根据中金财富出具的承诺函，其认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金，且符合该资金的投资方向。经核查中金财富的 2024 年年度审计报告，中金财富的货币资金足以覆盖其与发行人签署的配售协议中约定的承诺认购金额。

（5）相关承诺

根据中金财富出具的承诺函，中金财富承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

（二）限售期

根据前述参与战略配售的投资者与发行人签署的配售协议，除中金财富获得配售的股票的限售期为自该等股票上市之日起 24 个月、中金盛合一号资管计划获得配售的股票的限售期为自该等股票上市之日起 36 个月，其他前述参与战略配售的投资者获得配售的股票的限售期为自该等股票上市之日起 12 个月。

（三）结论

综上所述，本所认为，参与本次战略配售的投资者符合《发行承销实施细则》第四十一条等相关适用规则中对于参与战略配售的投资者选择标准和配售资格的相关规定。

二、 参与本次战略配售的投资者的配售情况

根据《发行承销实施细则》第三十八条第一款，首次公开发行证券可以实施战略配售。发行证券数量不足 1 亿股（份）的，参与战略配售的投资者数量应当不超过 10 名，战略配售证券数量占本次公开发行证券数量的比例应当不超过 20%。发行证券数量 1 亿股（份）以上的，参与战略配售的投资者数量应当不超过 35 名。其中，发行证券数量 1 亿股（份）以上、不足 4 亿股（份）的，战略配售证券数量占本次公开发行证券数量的比例应当不超过 30%；4 亿股（份）以上的，战略配售证券数量占本次公开发行证券数量的比例应当不超过 50%。根据《发行承销实施细则》第四十条，参与发行人战略配售的投资者，应当按照最终确定的发行价格认购其承诺认购数量的发行人证券。根据《发行承销实施细则》第五十一条，参与配售的保荐人相关子公司应当事先与发行人签署配售协议，承诺按照证券发行价格认购发行人首次公开发行证券数量 2%至 5%的证券，具体比例根据发行人首次公开发行证券的规模分档确定。发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元；发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民币 6,000 万元；发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人民币 1 亿元；发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。根据《证券发行与承销管理办法》第二十三条，发行人的高级管理人员与核心员工可以通过设立资产管理计划参与战略配售。前述资产管理计划获配的证券数量不得超过本次公开发行证券数量的 10%。

本次初始发行股票数量为 25,546.6162 万股，约占公司发行后总股本的 13.71%。本次发行后公司总股本为 186,277.4097 万股。本次共有 15 家投资者参与战略配售，本次发行初始战略配售的股票数量为 7,663.9848 万股，约占本次初始发行数量的 30%。

中金财富系保荐人（主承销商）中金公司的全资子公司。根据《发行承销实施细则》，中金财富将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票，具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定。中金财富初始跟投比例为本次初始发行股票数量的 5%，即 1,277.3308 万股，最终实际认购比例和金额将在确定发行价格之后确定。

根据《证券发行与承销管理办法》及中金盛合一号资管计划的管理人中金公司与发行人签署的配售协议，中金盛合一号资管计划认购股票数量将不超过本次公开发行股票数量的 10%，即不超过 2,554.6616 万股；同时，总认购规模不超过 31,500 万元，具体比例和金额将在确定本次发行的发行价格之后确定。

其他参与战略配售的投资者承诺认购的金额如下：

序号	参与本次战略配售的投资者名称	承诺认购金额（万元）
1	海光信息技术股份有限公司	10,000
2	中微半导体（上海）有限公司	10,000
3	上海天数智芯半导体股份有限公司	10,000
4	北京摩笔生成科技有限公司	10,000
5	沐曦数智（上海）科技有限公司	10,000
6	北京电控产业投资有限公司	8,500
7	聚辰半导体股份有限公司	6,000
8	上海复旦微电子集团股份有限公司	6,000
9	联芸科技（杭州）股份有限公司	6,000
10	北京昂瑞微电子技术股份有限公司	5,000
11	唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司	5,000
12	上海华虹宏力半导体制造有限公司	5,000
13	翱捷科技股份有限公司	3,500
总计		95,000

注：上表中“承诺认购金额”为参与本次战略配售的投资者与发行人签署的配售协议中约定的承诺认购金额，参与本次战略配售的投资者同意发行人以最终确定的发行价格进行配售，配售股数等于参与本次战略配售的投资者获配的申购款项金额除以本次发行的发行价格并向下取整。

基于上述，本所认为，本次战略配售符合《证券发行与承销管理办法》第二十三条及《发行承销实施细则》第三十八条第一款、第四十条和第五十一条的相关规定。

三、 本次战略配售不存在《发行承销实施细则》第四十二条规定的禁止性情形

根据发行人出具的承诺函、联席主承销商作出的承诺或说明及《中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司关于盛合晶微半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查的专项核查报告》以及参与本次战略配售的投资者出具的承诺函，本所认为，本次战略配售不存在《发行承销实施细则》第四十二条规定的以下禁止性情形：“（一）发行人和联席主承销商向参与战略配售的投资者承诺上市后股价将上涨，或者股价如未上涨将由发行人购回证券或者给予任何形式的经济补偿；（二）联席主承销商以承诺对承销费

用分成、介绍参与其他发行人战略配售等作为条件引入参与战略配售的投资者；（三）发行人上市后认购参与战略配售的投资者管理的证券投资基金；（四）发行人承诺在参与战略配售的投资者获配证券的限售期内，委任与该投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员，但发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外；（五）除《发行承销实施细则》第四十一条第三项规定的情形外，参与战略配售的投资者使用非自有资金认购发行人证券，或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；（六）其他直接或间接进行利益输送的行为”。

四、 结论意见

综上所述，本所认为，参与本次战略配售的投资者符合《发行承销实施细则》等相关适用规则中对于参与战略配售的投资者选择标准和配售资格的相关规定，且本次战略配售不存在《发行承销实施细则》第四十二条规定的禁止性情形。

附件 1：中金盛合一号资管计划参与人员名单

序号	姓名	主要职务	认购金额 (万元)	认购比例	劳动关系所属 公司	员工类 别
1	崔东	董事长兼 CEO	500	1.59%	发行人子公司 之分公司	高级管 理人员
2	李建文	资深副总裁兼 COO	800	2.54%	发行人子公司	高级管 理人员
3	林正忠	研发副总裁	570	1.81%	发行人子公司	高级管 理人员
4	吴畏	供应链与后勤 保障副总裁	700	2.22%	发行人子公司	高级管 理人员
5	周燕	副总裁兼董事 会秘书	770	2.44%	发行人子公司 之分公司	高级管 理人员
6	吴继红	市场与销售副 总裁	1,000	3.17%	发行人子公司 之分公司	高级管 理人员
7	赵国红	副总裁兼 CFO	1,500	4.76%	发行人子公司	高级管 理人员
8	刘慧甄	生产计划与交 付保障副总裁	500	1.59%	发行人子公司	核心员 工
9	沈月海	核心技术人员、 运营副总裁	1,100	3.49%	发行人子公司 之分公司	核心员 工
10	方建勳	运营副总裁	1,250	3.97%	发行人子公司	核心员 工
11	薛兴涛	核心技术人员、 研发资深总监	800	2.54%	发行人子公司 之分公司	核心员 工
12	俞忠良	核心技术人员、 运营资深总监	800	2.54%	发行人子公司	核心员 工
13	佟大明	核心技术人员、 运营总监	400	1.27%	发行人子公司 之分公司	核心员 工
14	陈寒清	财务资深总监	500	1.59%	发行人子公司	核心员 工
15	吴波	市场资深总监	500	1.59%	发行人子公司 之分公司	核心员 工
16	顾燕	人力资源资深 总监	400	1.27%	发行人子公司	核心员 工
17	何智清	运营资深总监	500	1.59%	发行人子公司	核心员 工
18	张昊	信息技术资深 总监	500	1.59%	发行人子公司 之分公司	核心员 工
19	保广文	研发资深总监	350	1.11%	发行人子公司 之分公司	核心员 工
20	李俊德	研发总监	100	0.32%	发行人子公司	核心员 工
21	李君茜	研发总监	300	0.95%	发行人子公司 之分公司	核心员 工
22	程艳珍	后勤保障总监	220	0.70%	发行人子公司	核心员 工

23	何为	工程项目总监	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
24	沈小勇	采购总监	300	0.95%	发行人子公司之分公司	核心员工
25	徐霞	进出口总监	260	0.83%	发行人子公司	核心员工
26	陈杰	销售总监	300	0.95%	发行人子公司之分公司	核心员工
27	杨晨	运营总监	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
28	简甬锭	运营总监	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
29	范青竹	法务总监	200	0.63%	发行人子公司之分公司	核心员工
30	施圣恋	总裁办总监	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
31	胡晓蓉	财务助理总监	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
32	胡益彰	研发助理总监	150	0.48%	发行人子公司	核心员工
33	雷雄	研发助理总监	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
34	张伟炜	研发助理总监	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
35	钱元彬	研发助理总监	100	0.32%	发行人子公司之分公司	核心员工
36	胡劲松	工程项目助理总监	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
37	郑黎	采购助理总监	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
38	王玲	研发助理总监	300	0.95%	发行人子公司之分公司	核心员工
39	李劼	研发助理总监	150	0.48%	发行人子公司	核心员工
40	陈水生	研发助理总监	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
41	周祖源	研发助理总监	150	0.48%	发行人子公司	核心员工
42	陈彦亨	研发技术专家	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
43	毛磊	工业规划助理总监	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
44	潘晓霞	销售助理总监	300	0.95%	发行人子公司之分公司	核心员工
45	刘春欢	销售助理总监	300	0.95%	发行人子公司之分公司	核心员工
46	李风华	人力资源助理总监	200	0.63%	发行人子公司	核心员工
47	陈鑫	运营助理总监	270	0.86%	发行人子公司	核心员工

48	李兵	运营助理总监	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
49	顾恩伟	运营助理总监	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
50	张正伟	运营助理总监	260	0.83%	发行人子公司	核心员工
51	吴欣华	运营助理总监	200	0.63%	发行人子公司	核心员工
52	HU BIN	信息技术助理 总监	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
53	魏永利	投资者关系助 理总监	100	0.32%	发行人子公司 之分公司	核心员工
54	邱伟豪	研发部经理	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
55	朱圣兵	研发部经理	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
56	王世荣	运营助理总监	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
57	朱桢毓	生产计划总监	200	0.63%	发行人子公司	核心员工
58	陈文财	运营助理总监	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
59	吴开春	厂务助理总监	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
60	王巍	厂务与环安总 监	200	0.63%	发行人子公司 之分公司	核心员工
61	李存亮	生产计划助理 总监	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
62	俞瑛楠	财务部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
63	刘世杰	研发部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
64	梅枫	研发部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
65	伍信桦	研发部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
66	仇月东	研发部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
67	梅建龙	工程项目部经 理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
68	蔡奇风	研发部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
69	陈辉	研发部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
70	江伟	研发部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
71	钱喜阳	客户服务部经 理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
72	蒋鸣	工业规划部经 理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工

73	王俊峰	销售部经理	100	0.32%	发行人子公司之分公司	核心员工
74	孟津	客户工程经理	100	0.32%	发行人子公司之分公司	核心员工
75	刘海丽	客户工程部经理	100	0.32%	发行人子公司之分公司	核心员工
76	陈郁青	销售部经理	100	0.32%	发行人子公司之分公司	核心员工
77	刘嘉鑫	客户工程部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
78	甘蕊	人力资源部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
79	李敏洁	人力资源部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
80	蒋晓明	生产计划部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
81	董红卫	运营部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
82	张海军	运营部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
83	肖展	运营部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
84	宋悦培	运营部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
85	承艳	运营部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
86	林开典	运营技术专家	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
87	曹天华	运营部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
88	袁启亮	信息技术部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
89	王永春	信息技术部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
90	李永华	质量部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
91	黄雪颖	投资者关系部经理	100	0.32%	发行人子公司之分公司	核心员工
92	张瞻	投资者关系经理	100	0.32%	发行人子公司之分公司	核心员工
93	丁洁	财务课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
94	俞磊	研发课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
95	赵晓明	研发课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
96	左盛	研发课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
97	王小社	研发课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工

98	周鹏	研发课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
99	周海峰	研发课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
100	秦开贤	研发课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
101	杨淼	研发部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
102	潘英	研发课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
103	郁海洋	研发课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
104	武沂泊	研发部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
105	卢春山	研发课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
106	李文波	客户工程课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
107	孙剑良	客户工程课经理	100	0.32%	发行人子公司之分公司	核心员工
108	薛浩	销售课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
109	吴顺	生产计划部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
110	张丽	生产计划技术专家	100	0.32%	发行人子公司之分公司	核心员工
111	唐修池	运营部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
112	童富荣	运营部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
113	李刚	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
114	张坤	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
115	胡祥民	运营部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
116	陆君凯	运营部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
117	葛飞	运营部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
118	梅伟	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
119	郑文	运营部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
120	张艳	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
121	王丹	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
122	夏斌	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工

123	陈智钧	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
124	韩辉	运营部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
125	张锦来	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
126	孙洪涛	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
127	王晓龙	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
128	冯玉亚	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
129	吉江	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
130	黄明	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
131	徐方	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
132	勾欢欢	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
133	陈伟	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
134	许斌	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
135	丁磊	信息技术课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
136	杨恭美	质量部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
137	余鸿飞	质量部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
138	尚琳琳	内审部经理	100	0.32%	发行人子公司之分公司	核心员工
139	王莹洁	财务课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
合计			31,500	100%	/	

注 1：中金盛合一号资管计划为权益类资管计划，其募集资金的 100%用于参与本次战略配售。

注 2：认购金额为以万元为单元进行四舍五入，合计数与各部分数直接相加之和若存在尾数差异系由四舍五入造成。

注 3：最终认购股数待确定发行价格后确认。

注 4：除保广文、程艳珍、何为、李风华、HU BIN、蒋鸣为退休返聘人员，因此与发行人的全资子公司、发行人全资子公司之分公司签署劳务合同外，上述其他人员均与发行人的全资子公司或发行人全资子公司之分公司签署了劳动合同。

（此页无正文，为《北京市海问律师事务所关于盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者专项核查的法律意见书》之签署页）

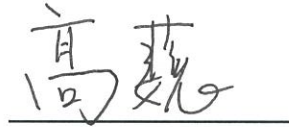


负责人：



张金恩

经办律师：



高 巍



魏双娟

2020年3月26日